



Global
Innovation
Center

第2回GICセミナー

「デンソーにおける車載半導体デバイスへの取り組み」

講師：加納 一彦氏

九州大学グローバルイノベーションセンター客員教授
[株式会社デンソー 基礎研究所基礎研究2部担当次長]

株)デンソーでは、1980年代からパソコンに搭載されているCPU (Central Processing Unit) や半導体メモリなどのLSI (Large-Scale Integration) 等を作製している微細加工技術を応用したMEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 技術というものをを用いて、車載半導体デバイス (センサ等) を量産してきた。

MEMS技術を用いて作製したデバイスの特徴は、“フォトファブリケーション”という手法を用いていることであり、それまでの機械加工で作製していたデバイスに対し加工精度が格段に向上し、同じデバイスが数千~数万個を同時に作製可能である。今回、カーエレクトロニクスの動向、この技術で開発してきた車載デバイス、またこのMEMS技術と複合するグラフェン等の新規材料開発について紹介する。

日時：平成28年11月22日 (火) 15:00~16:30

場所：グローバルイノベーションセンター3階 研修室

(福岡県春日市春日公園6-1 九州大学 筑紫キャンパス)

定員：60名 (先着順、お申し込み締切日：11/18 (金))

世話人：九州大学グローバルイノベーションセンター

アドバンスプロジェクト部門 新エネルギー領域

教授 吾郷 浩樹

【お申し込み先】

九州大学

グローバルイノベーションセンター
事務室 (筑紫キャンパス)

FAX : 092-573-8729

TEL : 092-583-7883

Mail : jim@gic.kyushu-u.ac.jp

GIC HP :

<http://www.gic.kyushu-u.ac.jp>